

芯碁微装 20260826

芯碁微装 2026H1 分析：订单超预期增长，先进封装与高阶 PCB 双轮驱动

摘要

- 2026H1 业绩超预期，净利同比增 104%，毛利率/净利率均超基准线；经营性现金流 2.91 亿元，11 年来首超净利润。
- 订单动能强劲，2026H1 新签订单超 18 亿元（含维保），已超 2025 全年；Q2 单季新签超 9 亿元，环比持续增长。
- PCB 业务结构优化驱动盈利，高阶 HDI 设备收入占比升至 42%-43%，毛利率达 46%；半导体业务预计下半年收入占比升至 20%以上。
- 先进封装进入爆发期，6 μm 机型已获鹏鼎、深南等头部客户批量订单；预计 2027 年半导体设备业务规模将与 PCB 业务平分秋色。
- 产能规划大幅提前，2026 年产值预期上调至 50-60 亿元；因现有产能趋于饱和，三期扩产选址计划由 2027 年提前至 2026H2。
- 技术迭代加速，4 μm /2 μm 高端机型需求旺盛，2 μm 首台设备 9 月交付；二氧化碳钻孔机验证通过，在手订单充裕但交付受限于物料。
- 全球化布局提速，港股上市资金助力海外市场；正对接台积电等头部客户 CoWoS 应用，PLP2000 型号同步对接北美客户。

Q&A

请介绍一下公司 2026 年上半年的整体业绩表现，包括营收、利润、现金流以及各业务板块和主要客户的构成情况？

2026 年上半年，公司实现了 11 亿元的营业收入，同比增长接近 70%。利润总额和扣非净利润的同比增速均超过 100%，分别达到 105%和 104%，显示出盈利能力的显著提升，毛利率和净利率水平均高于此前 40%和 20%的基准线。经营性现金流表现尤为突出，净额为 2.91 亿元，同比增长超过 300%，并且在公司成立 11 年来首次超过净利润总额，这反映了公司设备在行业中市场地位的转变以及交付能力的提升。从业务构成来看，半导体业务上半年确认收入超过 1.6 亿元，占总

营收约 15%；PCB 业务占比接近 80%（79.6%），其余为维保服务。在客户方面，前五大客户的营收占比略高于 50%，其中鹏鼎、深南电路位列前三。鹏鼎控股的收入确认尤为突出，上半年已确认 2.87 亿元，接近其 2025 年全年的 2.92 亿元，这与该公司近期在淮安、深圳等地的布局扩张相吻合。此外，公司于 2026 年 6 月 26 日在香港主板挂牌，目前总资产约 65 亿元，净资产接近 53 亿元。研发费用总额持续增加，但由于营收规模的快速扩大，研发费用占营收的比例有所下降。

关于公司 2026 年第二季度的新签订单情况，以及先进封装业务在今年上半年的发货与收入确认数量，并请展望该业务今年全年及明年的发展预期？

2026 年第二季度的新签订单额超过 9 亿元，高于第一季度的 8 亿元。整个上半年，不含维保服务的订单金额已超过 17 亿元，若包含维保服务，则上半年新签订单总额已超过 18 亿元，超过去年全年水平。其中，PCB 业务的订单占比较高，达到八成以上，而半导体业务的订单自 7 月份起开始加速。在先进封装业务方面，上半年确认收入的设备为 3 台，这些设备主要是在 2025 年底至 2026 年初发货的。尽管上半年确认数量不多，但 5 月至 7 月期间已发货了相当数量的设备，因此下半年的收入确认节奏将会加快。预计 2026 年全年的收入确认量将能达到或接近 10 台，而已发货的设备数量接近十余台。

基于当前各业务线的加速发展，公司对未来几年的产值增长有何预期，以及相应的产能规划是怎样的？

鉴于先进封装（特别是自 5 月份以来 FC-BGA 带来的需求）、PCB 以及钻孔设备（在解决上游供应链问题后）等各项业务均在加速发展，预计公司未来的增长速度将快于此前预期。根据当前趋势，2026 年的产值预计将在 50 亿至 60 亿元之间，超过了早前 40 亿至 50 亿元的预测。这意味着现有厂区的产能将在 2028 年之前提前达到饱和。因此，公司已将寻找新厂房以支持未来产能扩张的计划提上日程，预计将在 2026 年下半年确定选址，这比原计划的 2027 年有所提前。

在上半年仅确认了 3 台先进封装设备的情况下，第二季度的利润率仍实现了环比大幅增长，其主要驱动因素是什么？

尽管上半年先进封装业务对利润率的贡献相对有限，但第二季度利润率的显著提升主要得益于其他业务板块。

鉴于先进封装机台的收入确认预计在下半年大幅增加，是否可以预期下半年的毛利率将较上半年实现显著的环比增长？

是的，下半年先进封装的采购量预计会增多，台积电等客户的需求也在下半年呈现加速态势。2026 年上半年，包括先进封装、各类载板在内的半导体设备业务总收入约为 1.6 亿元。根据目前的交付和收入确认节奏，预计下半年该业务的收入至少将是上半年的两倍以上，保守估计将确认三至四亿元以上的收入。因此，

半导体业务在下半年的收入占比将显著提升。2026 年上半年，半导体业务占公司总收入的比例为 15%，预计全年占比将至少达到 20%以上。这意味着，仅看下半年的情况，半导体业务的收入占比将远高于上半年。

关于 mSAP 设备的市场景气度，考虑到下游客户在该领域的扩产力度较大，能否介绍一下公司 2026 年上半年 mSAP 设备的发货情况，以及基于当前与客户的接洽，对今明两年的订单预测是怎样的？

2026 年上半年，先进封装业务的收入确认主要从 5 月份开始加速，其中 mSAP 设备相关的收入约为 1 亿多元。对于解析精度在 15 微米以内的设备，特别是 6 微米和 4 微米的型号，预计 2026 年全年确认收入的设备数量可达六七十台。订单方面，预计全年可签订约 100 台，能够发货六七十台，并有信心完成同等数量的收入确认。

请问目前对载板设备业务在 2026 年和 2027 年的展望如何？

目前在统计口径上，并未将传统 BT 载板、ABF 载板与 mSAP 工艺所用的类载板设备进行严格区分。前述预计 2026 年签订近 100 台订单的口径，是包含了 mSAP 设备以及传统 BT 载板和 ABF 载板设备的总和。

近期市场感受到一些海外龙头客户，例如台积电，可能在激光直写技术方面进行前期对接，能否介绍一下海外龙头客户在直写技术领域的最新趋势，包括研发和项目对接的进展？

海外业务目前主要聚焦于台湾、马来西亚和北美市场。北美客户主要关注 PLP（Panel Level Package）应用，涉及 510mm×515mm 的大尺寸基板，对应的设备型号为 PLP2000，目前正在对接中。马来西亚的客户是一家合资公司，其总部与国内某公司有关联，因此项目导入速度较快，预计可能在 9 月底前落地。台湾市场方面，正在与当地规模排名第二的先进封装及 CoWoS 厂商积极对接，其应用主要为 310mm 尺寸的 CoWoS。此外，台湾规模最大的 CoWoS 厂商已在测试使用 LDI 技术，应用于其面积超过 3,500 平方毫米的四倍 reticle size 产品上。该厂商对 LDI 技术的测试和应用，将提升行业对该技术的认可度。当前阶段的重点是在 2026 年年底前敲定与前述三家客户的合作并开展进一步验证，后续第二阶段可能会与规模最大的台系厂商展开更深入的互动。

2026 年第二季度公司的毛利率和净利率均实现了显著的环比增长，考虑到先进封装业务的收入和利润贡献主要体现在下半年，这是否意味着二季度利润率的提升更多来源于 PCB 业务？具体而言，PCB 业务的产品结构改善体现在何处？AI 相关 PCB 设备在上半年的收入占比如何？未来随着 mSAP 业务放量，PCB 业务的毛利率将如何变化？

2026 年上半年，半导体业务的收入占比为 15%，毛利率约为 55%，与往年 53%-60% 的水平基本持平，因此其对整体毛利率的拉动尚不明显，预计下半年随着半导体业务收入占比提升至接近 30% 甚至更高，其对毛利率的拉动效应才会显著体现。上半年整体毛利率的提升，主要得益于 PCB 业务自身盈利能力的增强。从整体看，PCB 设备的毛利率达到了 40%，而往年通常在 35% 或以下。这主要归因于产品结构的优化，特别是应用于 AI 相关领域的高阶 HDI 板设备（如 MAS12，对应十几微米的线宽需求）的收入占比显著提升。2025 年，这类高阶设备占总收入的比重已超过 30%，而 2026 年上半年，其占 PCB 业务收入的比重已达到 42%-43%，预计全年可能占到 PCB 业务收入的一半。这类高阶机型的毛利率也较高，上半年平均达到了 46%。因此，上半年整体毛利率的增长主要是由 PCB 业务内部结构优化所驱动的。

MAS6P 这类用于 mSAP 工艺的设备在财务报表中是如何归类的？此外，客户结构方面有何特点？

公司将解析精度在 10 微米以内的设备，因其工艺接近半导体级别，统一归类于泛半导体业务中。在客户结构方面，鹏鼎控股是重要的利润来源。2026 年上半年，鹏鼎作为公司的第一大客户，占公司总营收的 26%。由于鹏鼎对产品要求较高，其订单的毛利率也保持在良好水平。

上半年 MAS6P 产品在半导体业务收入中的具体占比是多少？

目前还无法清晰拆分 MAS6P 的具体收入占比。MAS6 产品被归入整个半导体业务板块，该板块还包含先进封装和载板业务。2026 年上半年，整个半导体业务合计收入约为 1.69 亿元，体量相对较小，其收入确认预计将更多地反映在下半年。

考虑到公司二期产能在 2025 年底投产后，预计 2026 年将逐季上量，但面对当前行业景气度，即便二期产能满负荷运转也可能无法满足需求。请问公司对三期产能的规划和建设节奏有何看法？

目前公司各产品线产能均较为紧张。从交付压力来看，AI 换向母机最为突出，主要瓶颈在于上游物料的获取。对于 PCB 产品线，虽然产能同样紧张，但目前尚能按客户要求交付，公司也会与客户提前沟通以确保足够的交期，尽管批量订单的交付周期现在可能有所延长。展望明年（2027 年），合肥厂区的整体产能预计将面临满负荷运行的压力，因此公司正在积极规划如何进一步提升产能。当前交付压力最大的两款直写曝光机，月产量估计在 40 台左右。相比之下，PCB 设

备近三个月的月排产计划较为饱满，基本维持在 100 至 120 台的水平。包括 MSAP 设备在内的其他产品交期也可能需要延长，为此公司正积极储备马达等关键物料。

关于物料供应问题，五六月份时是否为最紧张的时期？目前上游供应链情况是否有所缓解，以及对明年（2027 年）物料瓶颈的预期是否会大幅好转？

从存货数据可以部分反映物料储备的趋势。截至 2026 年 6 月 30 日，公司存货金额达到 10 亿元，为历史最高水平，其中主要为提前储备的原材料。当前面临两个主要压力：其一是阿瓦扎激光器的供应量不足；其二是针对 6 μm 、4 μm 等高端机型的现场装调工程师培养速度跟不上需求。为应对后者，公司已启动制造专项，从资深工艺工程师中抽调人员重点支持高端机型的装调工作，直至年底。除阿瓦扎激光器外，其他物料的供应情况已得到部分缓解。此外，设备稳定性的显著提升也减轻了现场工程师的压力。与前两年相比，产品质量问题大幅降低，使得工程师在客户端的装调工作更为顺畅，即便面对大批量装机任务，现场压力也比预期要小。这表明公司内部可控环节的能力已在全力提升。

公司近期公告成立了上海青浦子公司“基石微”，请问该公司的战略定位和主要作用是什么？

设立上海子公司“基石微”的计划始于 2025 年，总投资额约 1 亿元。其核心定位首先是技术与研发，计划在上海建立一个研发平台实验室，并配套相应的实验和简易装配设施，旨在引进半导体领域的顶尖人才，特别是那些倾向于在一线城市工作的高端研发人员。上海在国家级研发项目资源方面也具备优势。其次，该子公司将承担设备销售、运维及市场开拓等职能。上海及周边地区聚集了众多 Fab 厂等大客户，设立据点便于业务沟通与布局，拓展包括直写光刻及其他设备在内的市场机会。最后，上海作为一线城市，在品牌宣传和行业交流方面具有窗口效应，行业内最重要的展会多集中于此，有助于提升公司品牌影响力。

在 PCB 业务中，mSAP 领域的客户结构、订单台数以及对 2027 年的展望是怎样的？

严格区分 MAS6 设备具体应用于 mSAP、类载板还是 BT 载板存在一定困难，因为客户通常会使用同一款机型从事多种业务。以 MAS 65T 机型为例，主要客户仍是鹏鼎和深南。2026 年上半年，独体生产模式已实现批量交付。从 6 微米设备机型来看，上半年约一半的交付量集中于这两家客户。其余客户则相对分散，例如深南、景旺、沪电、胜宏等客户刚刚完成验证，尚处于导入期，因此其贡献未在营收中明显体现。这些 PCB 企业在上半年积极进行 SLP 相关业务的验证，其新工厂也正在建设中。

贵公司 6 微米机型在头部 PCB 企业的验证进展如何？基于当前的交付周期和客户扩产计划，预计明后年的订单情况将呈现怎样的趋势？

上半年，公司 6 微米机型已在主要的头部 PCB 企业中通过验证。基于目前 4-5 个月的交付周期，相较于日资企业至少一年的等待时间且产能不确定的情况，公司具备显著优势。今年上半年已开始向鹏鼎、深南等头部客户进行批量交付。其中，鹏鼎因去年已完成 6 微米机型的验证，今年订单增长迅速；深南则是在去年底完成验证，今年一季度表现良好，二季度已开始发货验收。其他多家 PCB 企业也在上半年完成了该新机型的验证导入，其批量发货和验收预计将在下半年开始，但更大规模的放量预计在明年。考虑到胜宏的两个车间以及鹏鼎位于淮安和深圳的工厂（深圳工厂 7 月份动工）等客户的建厂周期，预计明年将是订单快速增长的关键时期。初步估算，仅几家头部客户对 M35 机型的需求，明年可见的订单量就可能达到 200-300 台。此外，景旺、兴森、红板、东山精密等其他 PCB 公司扩产意愿积极，预计将在今年下半年至明年完成设备验证并实现放量，因此明年整体市场需求将非常可观。

除了 6 微米机型，公司在面向 ABF 载板的 mSAP 工艺方面，4 微米和 2 微米设备的研发进展、市场需求以及交付能力准备情况如何？

4 微米设备作为今年的升级机型，首台设备刚完成，但目前已有五六台的客户订单在等待交付。与过去需要主动寻求客户验证不同，现在 4 微米和 2 微米设备在研发阶段就已收到大量客户需求。2 微米机型的首台设备计划于 9 月份交付，同样面临多家客户争抢的情况。这种市场需求的变化给公司的交付能力带来了压力。为应对 2、4、6 微米等高精度设备的交付挑战，公司已开始为明年的大规模交付进行准备，包括提前储备工程师资源，并已制定了确保明年交付能力的内部目标。

从行业层面看，为满足国内算力芯片的先进封装需求，预计到 2027-2028 年，国内 OSAT 等企业在 CoWoS 和 CoPoS 领域的布局将催生多大的设备市场空间？特别是 2 微米设备的总需求量预计有多少？

2 微米设备主要应用于圆形的 CoWoS、方形的 PLP（Panel Level Packaging），以及 WLP、高阶 ABF 基板、高阶玻璃基板、MEMS 探针、CIS 等先进封装领域。综合考虑这些应用，初步预计到明年及后年，国内市场的设备总需求量将超过 200 套。至于海外市场，由于尚未正式落地，具体规模尚不明确，但可以通过对接的工厂及终端用户的规模进行反向推算。

随着半导体业务进入高景气周期，公司现有产能是否饱和？对于后续的三期、四期厂房建设，公司有何规划和选址考量？

公司确实在为应对增长需求而准备新的产能建设，即三期项目。在选址方面正在考虑合肥以外的地区，重点关注深圳、东莞及周边区域。主要原因区拥有更成熟的供应链和集中的客户群。此外，公司也在考虑在新加坡或



亚建立一个境外生产基地，以支持海外业务，但这并非当前重点。现阶段的重心仍是国内的产能扩张，因为国内在供应链、产业工人和成本控制方面具备更成熟的条件。相关计划预计在今年下半年推进。

请问公司二氧化碳钻孔机在 2025 年及 2026 年上半年的确认收入与交付情况如何？目前在手订单及主要客户是怎样的，以及公司如何应对当前的交付挑战？

公司的二氧化碳钻孔机在 2025 年并未确认收入，但交付了大约两到三台。该设备与华南某大客户合作开发已有四五年时间，直到 2025 年年底（约 11 月或 12 月）才在客户端完成验证。今年（2026 年）验证通过后开始获得订单，第二季度的订单成交情况超出了预期。目前订单量最大的客户是宏启，该客户对设备非常了解并给予了肯定。上周（2026 年 8 月中下旬），宏启方面曾到公司催促二氧化碳钻孔机的交货，其在手订单约有 100 多台，希望公司能尽快交付。公司近期已与该客户签订了其中约一半（四五十台）的订单，但客户认为数量仍然不够，且交付周期较慢，因此希望公司能加快交付速度。当前交付能力受限的问题预计在 2026 年年底前难以得到根本改善，公司正在寻求物料产能的解决方案，并积极推进国产化方案。同时，公司也在向沪电、深南等其他 PCB 客户导入设备并进行验证，例如沪电的设备正在装调，深南的机台也正在协调发货。对于 2027 年的需求订单，公司并不担心，当前的重点是解决交付能力问题。

请介绍一下芯碁微装在 2026 年和 2027 年的整体发展战略，尤其是在先进封装领域的客户进展和未来展望？

公司 2026 年整体发展迅速，上半年实现的利润已基本与 2025 年全年持平，销售收入增长显著，在手订单非常充裕。公司在技术、研发、内部运营及交付能力方面进行了全面提升，为承接此轮增长做好了战略准备。2026 年下半年，公司在高端制程和先进领域的增长超出预期，尤其是在先进封装和 IC 载板部分。当前，无论是 ABF 载板还是 BT 载板的产能都严重紧缺，鹏鼎、深南电路、兴森快捷以及一些台资大厂等龙头企业都在加速扩产。2026 年可视为先进封装发展的元年，公司的设备已获得头部大厂的充分认证，相关代工企业的订单增速非常快。公司对 2027 年进行了保守、中等和乐观三种情景的预测，数据显示增长将非常可观。预计到 2027 年，半导体相关设备的业务规模可能与 PCB 设备业务平分秋色。尽管公司一向持谨慎乐观态度，但目前观察到的商机和客户客观需求已远超原有预期。

随着业务进入加速增长期，公司在新增产能和国际化布局方面有何规划？特别是在海外客户开拓方面，未来一两年的具体想法是什么？

在产能方面，公司 2025 年投产的新厂房已投入使用。2026 年，公司正根据市场情况对内部厂房进行优化和结构调整，以满足产能增长对场地的需求，并已为此做了前瞻性规划。同时，公司正在全面加强人力资源建设，包括人才招聘、储备及内部培养，以确保能够承接未来的产能扩张需求。在国际化布局方面，港股上

市募集的资金将重点用于全球化战略。近期，公司在印度和欧洲市场均取得了积极进展。预计 2026 年下半年，在 WLP 领域将与海外国际大客户实现重要突破。此前已设立的泰国子公司正在推进具体业务，同时为应对未来的国际贸易格局，公司也在考虑在中国香港、新加坡等地进行布局，包括吸纳海外技术研发人才和进行国际品牌建设的准备。当前的核心工作是，一方面通过密集拜访头部大客户，进行深度的战略绑定；另一方面，积极挖掘和培育核心供应链，加快国产化替代进程，以降低供应链风险。